



中华人民共和国国家军用标准

FL 6133

GJB 1420B-2011
代替 GJB 1420A-1999

半导体集成电路外壳通用规范

General specification for packages of semiconductor integrated circuits

2011-12-25 发布

2012-04-01 实施

中国人民解放军总装备部 批准

目 次

前言	II
1 范围	1
2 引用文件	1
3 要求	1
3.1 总则	1
3.2 合格鉴定	1
3.3 产品保证要求	1
3.4 质量保证大纲	1
3.5 统计过程控制	1
3.6 工艺检测计划	1
3.7 材料和镀覆	2
3.8 设计和结构	3
3.9 电特性	3
3.10 标志	3
4 质量保证规定	4
4.1 检验分类	4
4.2 检验条件	4
4.3 批的组成	4
4.4 材料检验	4
4.5 筛选	4
4.6 鉴定检验	4
4.7 质量一致性检验	6
5 交货准备	8
5.1 包装要求	8
5.2 储存	9
6 说明事项	9
6.1 预定用途	9
6.2 分类	9
6.3 订购文件应明确的内容	9
附录 A (规范性附录) 陶瓷外壳外观目检要求	10
附录 B (规范性附录) 镀层质量试验方法	38

前 言

本规范代替 GJB 1420A—1999《半导体集成电路外壳总规范》。

本规范与 GJB 1420A—1999 相比主要变化如下：

- a) 第 3 章部分内容进行了调整；
- b) 鉴定检验的样本大小、试验分组进行了调整；
- c) 增加了镀镍质量考核试验方法(附录 A.2)；
- d) 增加了陶瓷外壳外观检验要求(附录 B)。

本规范附录 A 和附录 B 是规范性附录。

本规范由中国人民解放军总装备部电子信息基础部提出。

本规范起草单位：工业和信息化部电子第四研究所、中国电子科技集团公司第五十八研究所、宜兴电子器件总厂、中国电子科技集团公司第十三研究所。

本规范主要起草人：李 锐、陈裕焜、丁荣峥、郑宏宇、史丽英。

本规范于 1992 年首次发布，于 1999 年第一次修订，本次为第二次修订。